

证券代码：688260

证券简称：昀冢科技

苏州昀冢电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2024 年半年度业绩说明会的全体投资者
会议时间	2024 年 9 月 4 日 15:30-16:30
会议地点	价值在线 (https://www.ir-online.cn/) 网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：王宾 董事会秘书、财务总监：陈艳 独立董事：刘海燕
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1：公司 2024 年半年度归母净利润同比有所改善，主要原因是什么？未来有什么扭亏为盈的计划吗？</p> <p>答：报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-2,754.92 万元，较上年同期相比亏损减少 2,125.78 万元，同比收窄 43.55%，主要原因为：1、受益于国内智能手机终端市场需求复苏、下游客户订单增长，2024 年上半年公司主营业务总体上呈现向好态势；2、报告期内，公司优化提升资产结构，聚焦资源，收缩对半导体引线框架业务的投资，放弃对控股孙公司池州昀杉的优先增资权及实际控制权，有效改善了公司财务结构健康度，报告期内公司非经常性损</p>

益增加 5,017.84 万元，导致净利润指标显著提升。

未来公司将持续聚焦主业，强化研发能力，重点推进 CMI 三代及四代产品的市场占有率，带动公司营收及盈利能力持续提升；同时加速新业务的研发和市场拓展，持续提升 MLCC 产品的工艺及技术水平，为公司创造新的营收增长点；此外，公司将采取多元的融资手段，有效改善资本结构及现金流，推动公司稳健、健康发展。

问题 2：2024 年半年度公司归母扣非净利润同比变动的主要原因是什么？

答：报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,510.53 万元，较上年同期相比，主要变化原因是由于 MLCC 业务处于成长期，伴随池州昀冢 MLCC 投资项目进入小批量量产阶段，在建工程转固导致折旧等相关费用大幅增加，以及人工、材料等运营成本增加所致，在报告期内对公司合并报表归属于上市公司股东的净利润影响为同比亏损增加 4,862.91 万元，其中 MLCC 项目研发费用影响同比增加 1,847.76 万元，研发费用主要构成为直接投入费用、人员费用、折旧费用等。

问题 3：贵司目前在电子陶瓷领域拓展情况如何？未来有何战略布局规划？

答：在电子陶瓷领域，公司主要布局 MLCC 和 DPC 两大块业务。在 MLCC 业务方面，报告期内公司持续加速 MLCC 高容量、小尺寸等重点产品的研发和市场布局。2024 年为公司 MLCC 产品销售元年，产品包括 0201、0402 等尺寸的系列产品，覆盖消费电子、汽车电子、通信及其他工业等多领域市场应用。MLCC 业务作为公司中长期策略发展领域，目前已建立了完善的

工艺流程、全面品质管理体系，产品研发进程有序推进。报告期内，公司 MLCC 团队积极推进 IATF16949 汽车业质量管理体系认证，并计划于 2024 年底前获得相关认证资质，为公司 MLCC 业务的拓展奠定良好的基础。在 DPC 业务方面，公司自主开发了预制金锡陶瓷热沉产品，包括预制金锡的氮化铝、碳化硅等产品，该类产品具有高耐热、高绝缘性、高导热率等特点，被广泛应用于高功率激光器、激光切割、激光焊接等领域。未来伴随着高端制造产业升级，公司 DPC 业务规模有望持续增长，为公司创造新的利润增长点。

问题 4：公司 CMI 业务发展情况如何？相关产品的市场占有率及市场应用情况是怎样的呢？

答：CMI 系列是公司自主研发的集成化产品，依靠冲压-成型-SMT-封装-电测等综合技术要素所形成的高集成化产品，其在技术工艺及市场占有率上一一直保持领先水平。公司 CMI 产品已逐渐从中高端手机下沉到单机价格千元左右的手机终端应用，有效带动了公司一二代 CMI 产品的市场渗透率。在高端机型和旗舰机领域，公司积极推动 CCMI 产品在潜望式长焦摄像头的应用，满足客户对摄像头马达更高的技术和功能需求。未来，伴随智能手机光学摄像功能的升级，公司 CMI 产品市场规模有望持续增长。

问题 5：2024 年上半年公司研发投入与去年同期相比有所增长，主要投入哪些领域？未来是否会继续加大研发投入？

答：报告期内，公司研发费用为 5,734.64 万元，同比增长 45.65%，主要是报告期内 MLCC 业务处于研发和试产阶段，导致研发投入同比大幅增长。

问题 6：公司 MLCC 业务发展如何，相关业务进展

	<p>怎么样？</p> <p>答:公司主要定位于开发中高端 MLCC 产品，在高容量、小尺寸产品的开发和技术突破上进展符合预期。2024 年为公司 MLCC 产品销售元年，产品包括 0201、0402 等尺寸的系列产品，覆盖消费电子、汽车电子、通信及其他工业等多领域市场应用。2024 年，公司 MLCC 团队积极推进 IATF16949 汽车业质量管理体系认证，并计划于 2024 年底前获得相关认证资质，为公司 MLCC 业务的拓展奠定良好的基础。</p> <p>问题 7：请问公司 DPC 相关产品主要有哪些？</p> <p>答:公司自主开发的预制金锡陶瓷热沉产品，包括预制金锡的氮化铝、碳化硅等陶瓷热沉产品。氮化铝主要应用领域为激光切割、激光焊接、激光打标、设备中的泵浦源、直接半导体激光器等，碳化硅主要应用领域为万瓦级高功率激光器、激光切割等。</p> <p>问题 8：AI 趋势对摄像头有没有什么新要求，对公司产品要求或者价值量上有什么新变化吗？</p> <p>答:公司主要聚焦 3C 领域精密零部件的开发和生产，目前产品主要应用在智能手机摄像头中的音圈马达 VCM 和摄像头模组 CCM 中。伴随 AI 新技术发展及新产品开发，智能化、轻量化和小型化的设计需求更加明显。公司会持续关注市场前沿技术的创新及产品升级迭代，积极把握市场动态。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应当披露重大信息。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 9 月 5 日</p>